

半導体デバイスの3D集積化プロセスと 先進パッケージ

～2.5D、チップレット、Siブリッジ、Fan Outパッケージの基礎と今後の課題～

講師：江澤弘和氏（神奈川工科大学・工学部・非常勤講師）

急速な伸張を続けるAI、HPC市場に向けて、国内でも俄かに先端半導体デバイス開発の機運が高まっています。その具現化には半導体素子の微細化開発だけでなく、パッケージ技術の高品位化によるシステムモジュールの性能向上、多機能創出への寄与が不可欠です。異種デバイスの3D集積化は材料、装置、デバイス製造、設計、テストを含む広範な境界領域における相互の地道な開発の上に成立する技術であり、関連する国内産業の世界的な優位性を維持できる技術分野です。本セミナーでは、チップレット、Siブリッジ、Fan Outパッケージの基礎を再訪し、2.5Dから3D集積化へ進展した開発経緯を整理しながら、“深化”を続ける先進パッケージの今後の動向を展望します。

【経歴】 (株)東芝で、30年以上、Si半導体デバイス、多層配線、Pb-free C4、Micro-Bump、RDL、TSV、WLPのプロセス開発、先端ロジック、CMOSイメージセンサ、メモリの中間領域応用製品の開発に従事。2017年から東芝メモリ(株)。2019年9月に定年退職。2018年より神奈川工科大学・非常勤講師。2020年5月から個人コンサルティング事業(ezCoworks)運営。

【活動】 日本金属学会、IEEEに所属。

開催日時	2023年7月25日(火) 13:30~16:30	※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。 詳細は裏面をご覧ください。
受講料	44,000円(税込) ※資料付 *メルマガ登録者 39,600円(税込) *アカデミック価格 26,400円(税込)	

アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限りです。

★【メルマガ会員特典】2名以上同時申込かつ申込者全員がメルマガ会員登録していただいた場合、1名あたりの参加費がメルマガ会員価格の半額となります。

★【セミナー対象者】・今さら聞けない基礎の再確認をしたい中堅技術者の皆様・先進半導体パッケージの動向に関心のある営業マーケティングの皆様・LCDパネル関連メーカーで半導体パッケージに関心のある皆様

★【得られる知識】・後工程の前工程化、技術階層を横断するプロセス開発の視点・3D集積化プロセスの基礎

【本セミナーのプログラム】

※適宜休憩が入ります。

- Current Topics
- 中間領域プロセスの新展開
- 三次元集積化の基幹プロセスの基礎
 - TSV・Hybrid-bonding
 - 2.5DからRDL interposer, Si Bridge, 3D chipletへ至る開発推移
 - 再配線の微細化・多層化・信頼性
- Fan-Out型パッケージ形成の基礎
 - プロセスの現状と課題(材料物性指標・コスト構造事例)
 - Through Mold Interconnect(TMI)による3D Fan-Out integration
- Panel Level Process(PLP)の進展
 - プロセスの高品位化と量産化の課題
 - Hybrid product scheme
- おわりに
市場概観と今後の開発動向
- Q&A

弊社記入欄		ウェビナー申込書			
セミナー名		半導体デバイスの3D集積化プロセスと先進パッケージ			
所定の事項にご記入下さい メルマガ会員、登録希望の場合は○↓		会社名(団体名)	TEL :		
		住所 〒	FAX :		
		E-mail :			
会員登録済み	新規登録希望	部署	役職	氏名	
お支払方法		銀行振込 ・ その他		お支払予定	2023年 月 日頃

■申込方法: セミナー申込書にご記入の上 FAX または E-mail(re@cmcre.com)でお申し込みください。

■セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりません、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

■申込先 : (株)シーエムシー・リサーチ 東京都千代田区神田錦町2-7 TEL 03-3293-7053

■本セミナーの関連情報は、弊社HPでもご覧になれます。⇒ <https://cmcre.com>

参加申込 FAX 番号
03-3291-5789

2023年7月25日(火)開催

半導体デバイスの3D集積化プロセスと 先進パッケージ

～2.5D、チップレット、Siブリッジ、Fan Outパッケージの基礎と今後の課題～

講師:江澤弘和氏

神奈川工科大学・工学部・非常勤講師

当該セミナーは、**ライブ配信のウェビナー（オンラインセミナー）**です！

【ライブ配信対応セミナー】

- 本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。お申し込み前に、下記 URL より視聴環境をご確認ください。
→ <https://zoom.us/test>
- 当日はリアルタイムで講師へのご質問も可能です。
- タブレットやスマートフォンでも視聴できます。
- お手元の PC 等にカメラ、マイク等がなくてもご視聴いただけます。この場合、音声での質問はできませんが、チャット機能、Q&A 機能はご利用いただけます。
- ただし、セミナー中の質問形式や講師との個別のやり取りは講師の判断によります。ご了承ください。
- 「Zoom」についてはこちら↓をご参照ください。

<https://zoom.us/jp-jp/meetings.html>

【お申込み後の流れ】

- 開催前日までに、ウェビナー事前登録用のメールをお送りいたします。お手数ですがお名前とメールアドレスのご登録をお願いいたします。
- 事前登録完了後、ウェビナー参加用 URL をお送りいたします。
- セミナー開催日時に、参加用 URL よりログインいただき、ご視聴ください。
- 講師に了解を得た場合には資料を PDF で配布いたしますが、参加者のみのご利用に限定いたします。他の方への転送、WEB への掲載などは固く禁じます。
- 資料を冊子で配布する場合は、事前にご登録のご住所に発送いたします。開催日時に間に合わない場合には、後日お送りするなどの方法で対応いたします。

【注意事項】

- 本セミナーの受講にあたっての推奨環境は「Zoom」に依存します。受講者の方のお手元の PC などの設定や通信環境が受信の状況に大きく影響いたしますので、ご自分の環境が対応しているか、お申し込み前の確認をお勧めいたします。

<https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC->

[MacLinux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6](https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-MacLinux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6)

- Zoom クライアントは最新版にアップデートして使用してください。
- インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声乱れる場合があります。また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合がありますが、予めご了承ください。
- 万が一、当社や講師側（開催側）のインターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止した場合には、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
- 本セミナーはお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
- 受講中の録音・撮影等は固く禁じます。
- Zoom のグループにパスワードを設定しています。お申込者以外の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
万が一外部者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。